

Products Information

▶ 主な特長

- コネクタの挿入力を低減します
特に、ピン・ソケットの双方の端子に用いた場合、従来のリフロー錫めっきと比べ、動摩擦係数を40%程度低減できます
- 電気的な接続信頼性に優れ、120°C-1000時間の耐熱試験後も抵抗値の上昇はありません
- Cu-Mg系銅合金MSPシリーズをはじめ、各種銅および銅合金との組み合わせが可能です

▶ 主な用途

- 車載用多極コネクタに用いられる小型端子

▶ 対応めっき工法

- 加工はフープめっきで行い、先めっき(条材)及び後めっき(プレス材)に対応しています
※ 後めっきは特許ライセンス先であるめっき加工会社での対応となります



先めっき

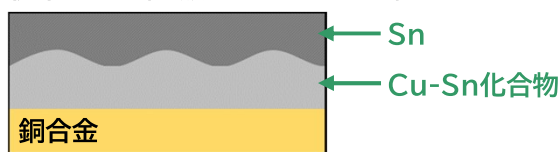


後めっき

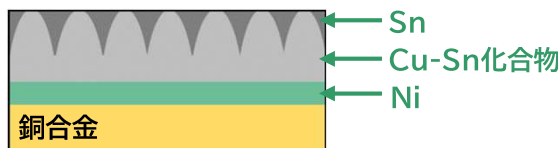
▶ めっきの構造

- Ni下地層の上に微細なCu-Sn化合物を有し、その一部を表面に露出させた独自の構造です
- Cu-Sn化合物の隙間に多くの純Snが残存した複相組織により低摩擦化と接続信頼性を両立します

従来めっき(一般的なリフローSn)

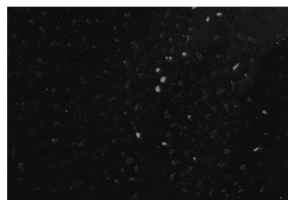


PICめっき®

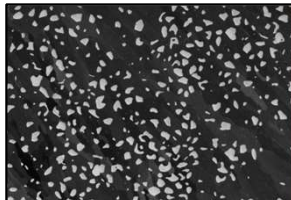


めっき断面模式図

従来めっき



PICめっき®



白い部分がCu-Sn化合物

めっき表面SEM像

▶ 動摩擦係数

